



2024年3月期 第2四半期 決算説明資料

東証スタンダード 証券コード：6614

2023年11月10日

売上高および各利益とも概ね計画以上の進捗

- 第2四半期まで半導体市場環境の影響を保守的に予想していたが、大きな影響を受けなかったため予想を上回る進捗。下期に向けては半導体後工程商材、特にバーンインボードに一服感の到来が予想される。
- 売上高は、電子システム事業が先期2Qから引き続き堅調、材料調達の影響も緩和され、計画比及び前期比でも増収。
- 経常利益は、価格転嫁の進捗及び調達コスト等の削減により、計画比及び前期比でも増益。従来当社は下期の売上ウェイトが高い傾向だが、今通期においては下期に市場環境の厳しい局面が予想される。
- 下期に向けた市場環境を考慮し、業績見通しは据え置く。

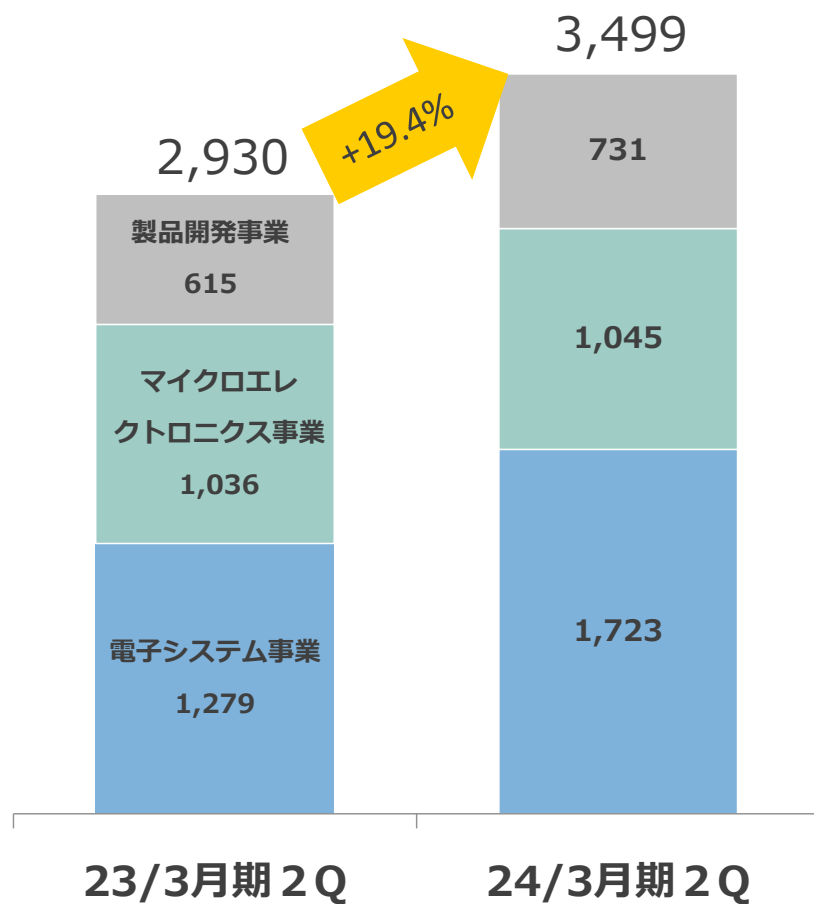
(単位：百万円、%)

	2024/3期 通期予想		2024/3期 2Q実績 (累計)		通期予想比	前年同期比
	金額	構成比	金額	構成比	進捗率	増減率
売上高	6,680	100	3,499	100	52.4	19.4
販管費	1,413	21.2	585	16.7	41.5	9.7
営業利益	560	8.4	348	10.0	62.3	47.7
営業利益率	8.4		10.0		—	+1.9
経常利益	560	8.4	355	10.2	63.5	47.1
当期純利益	430	6.4	248	7.1	57.7	51.3

半導体生産増による半導体後工程商材、新製品用カスタムバーンインの受注及び車載製品用専用計測機器の受注が引き続き堅調で、電子システム事業が大幅増収（前期比+34.7%）マイクロエレクトロニクス事業は堅調、製品開発事業も前期比+18.9%の増収。

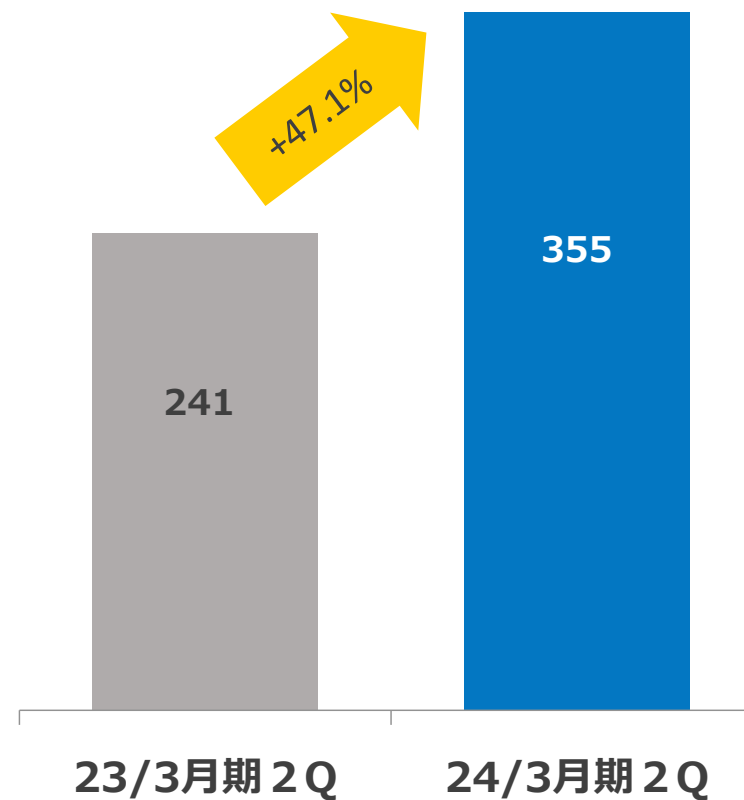
【売上高】

(単位：百万円)



【経常利益】

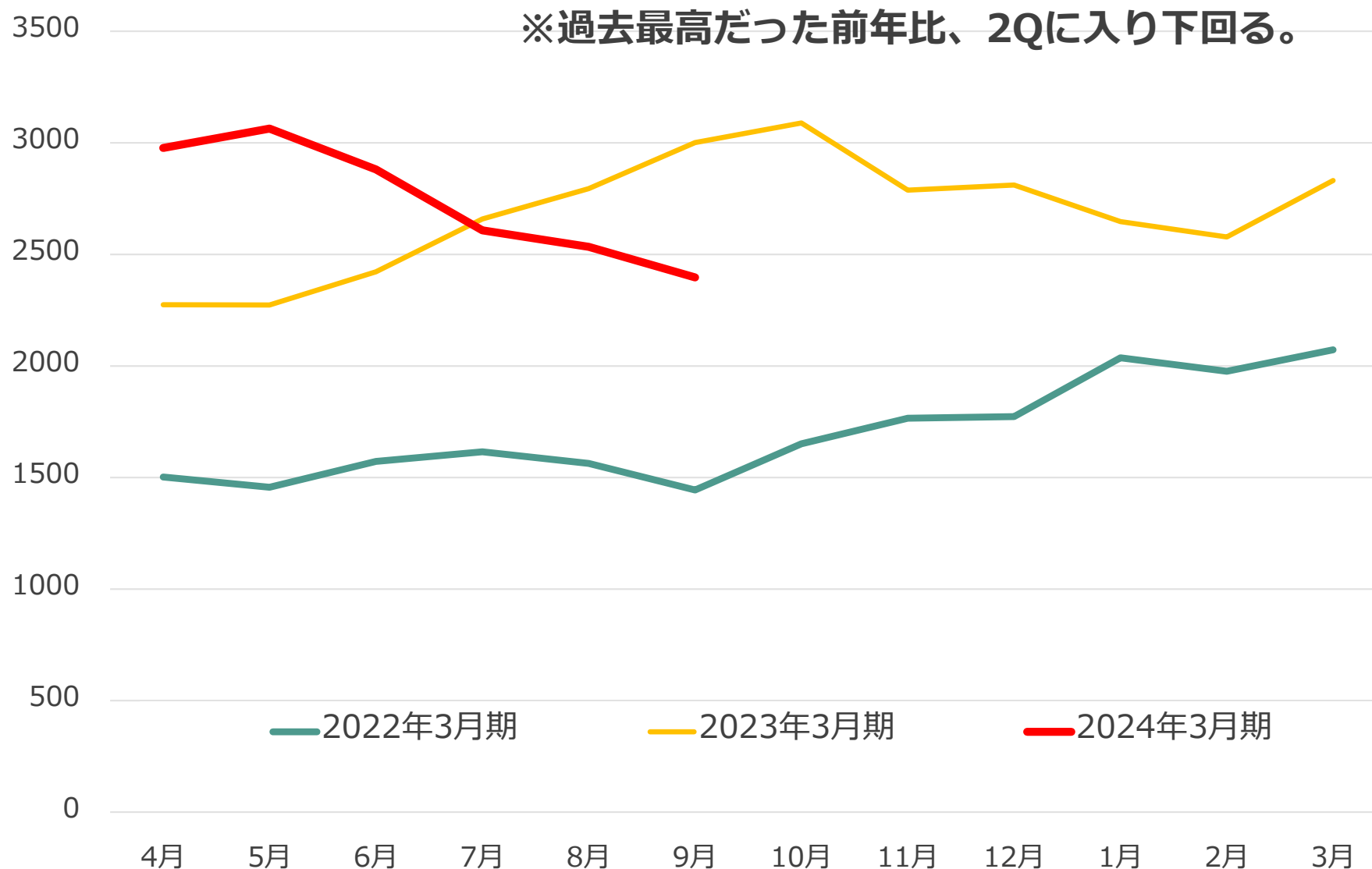
(単位：百万円)

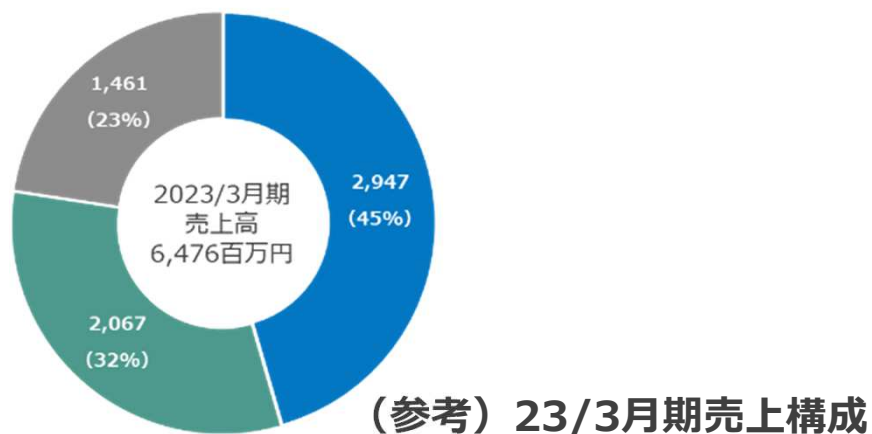
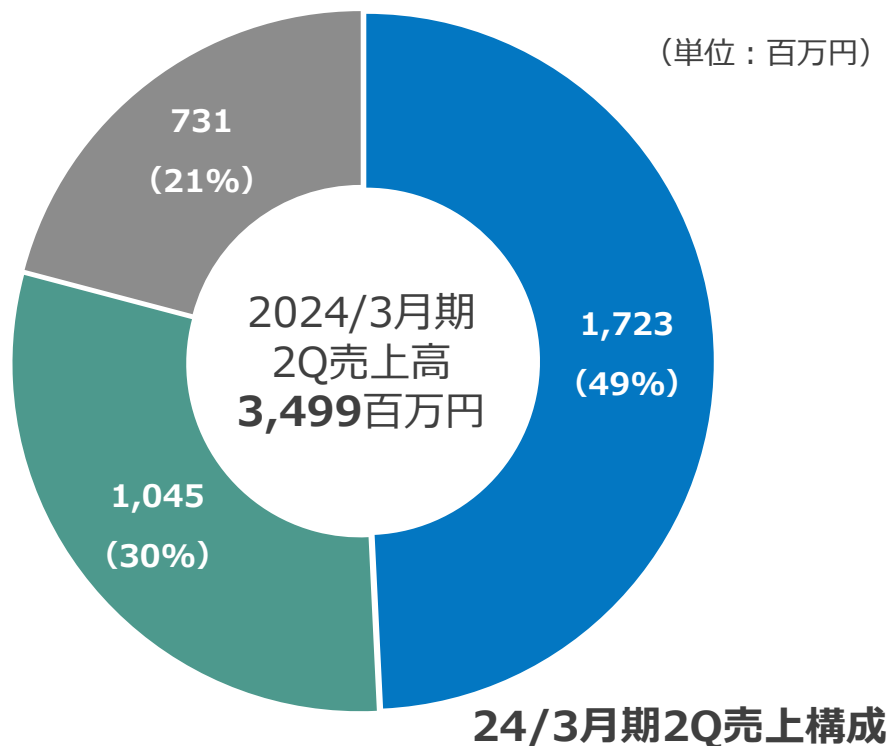


※売上高・経常利益とも前期比で増収増益。

【受注残高（全社）】

(単位：百万円)





電子システム事業

半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、高速通信機器、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、電子機器の開発・設計・製造

マイクロエレクトロニクス事業

LSI設計（アナログ・デジタル）、IPコア

電源IC設計、高速I/F設計、イメージセンサ設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計、技術者派遣、JPEG、MIPI、ISP

製品開発事業

組み込みカメラモジュール・画像システム

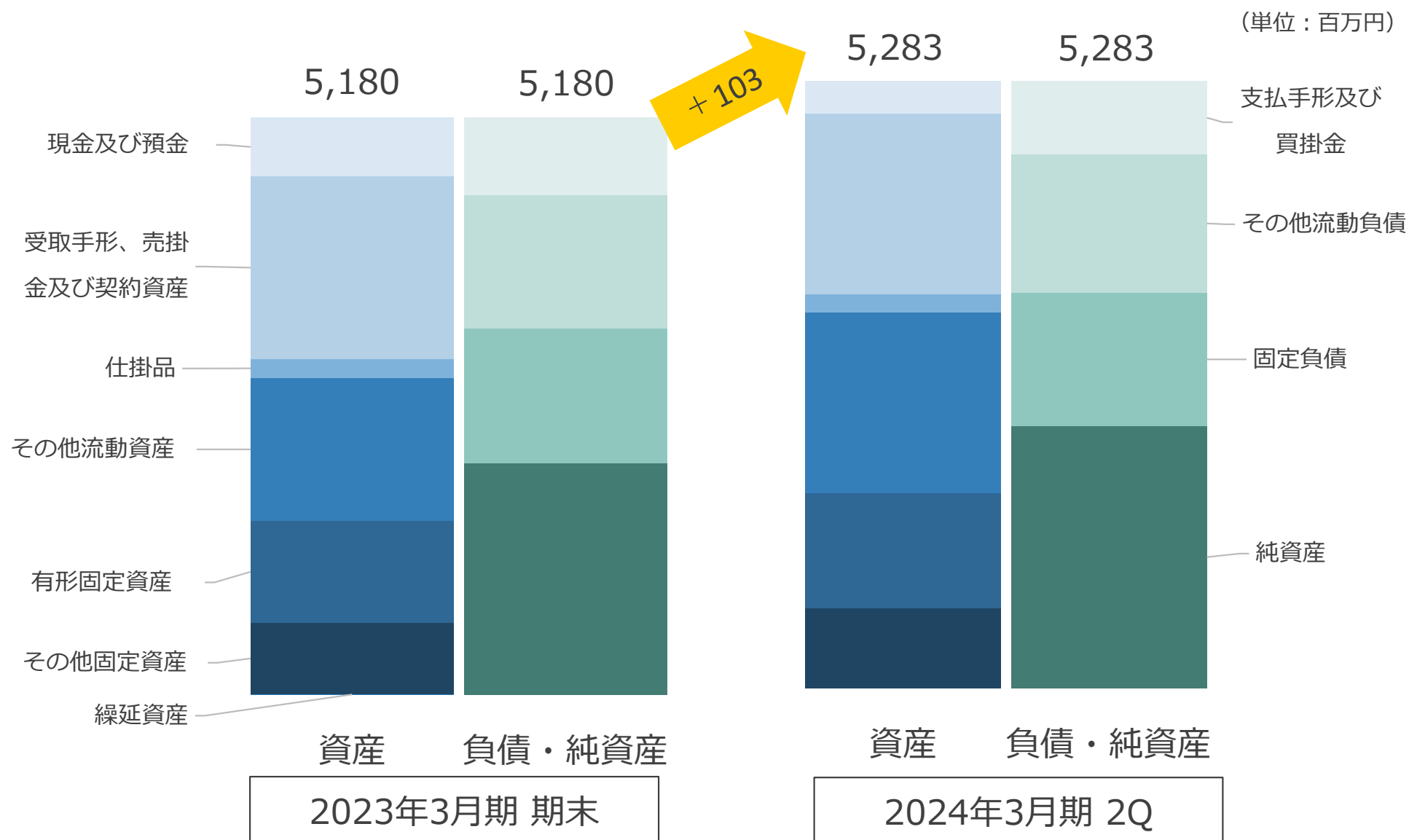
画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理システム、画像処理モジュール

貸借対照表

【固定資産】 第二工場稼働、本社内レイアウト改善等により建物148百万円増加。

【負債】 負債合計93百万円減少。（流動負債▲52・固定負債▲41）

【純資産】 利益計上で純資産197百万円増加。自己資本比率43.1% +2.9ポイント。



2023年

4月 5日～
4月 7日 第32回 Japan IT Weekに出展

4月 17日 130万画素MIPI出力カメラモジュール ルネサス製マイクロプロセッサ RZファミリのカメラ制御ドライバの提供開始

5月11日 決算発表

剰余金の配当（増配）をリリース

5月15日 富山県魚津市の第二工場の稼働開始

5月 22日 譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議

6月 8日 決算説明会

6月28日 第51期 定時株主総会

7月 5日 スーパーフレックスタイム制の導入

8月 4日 NECプラットフォームズ株式会社様より納期貢献への感謝状授与

8月23日 「指名・報酬委員会」設置

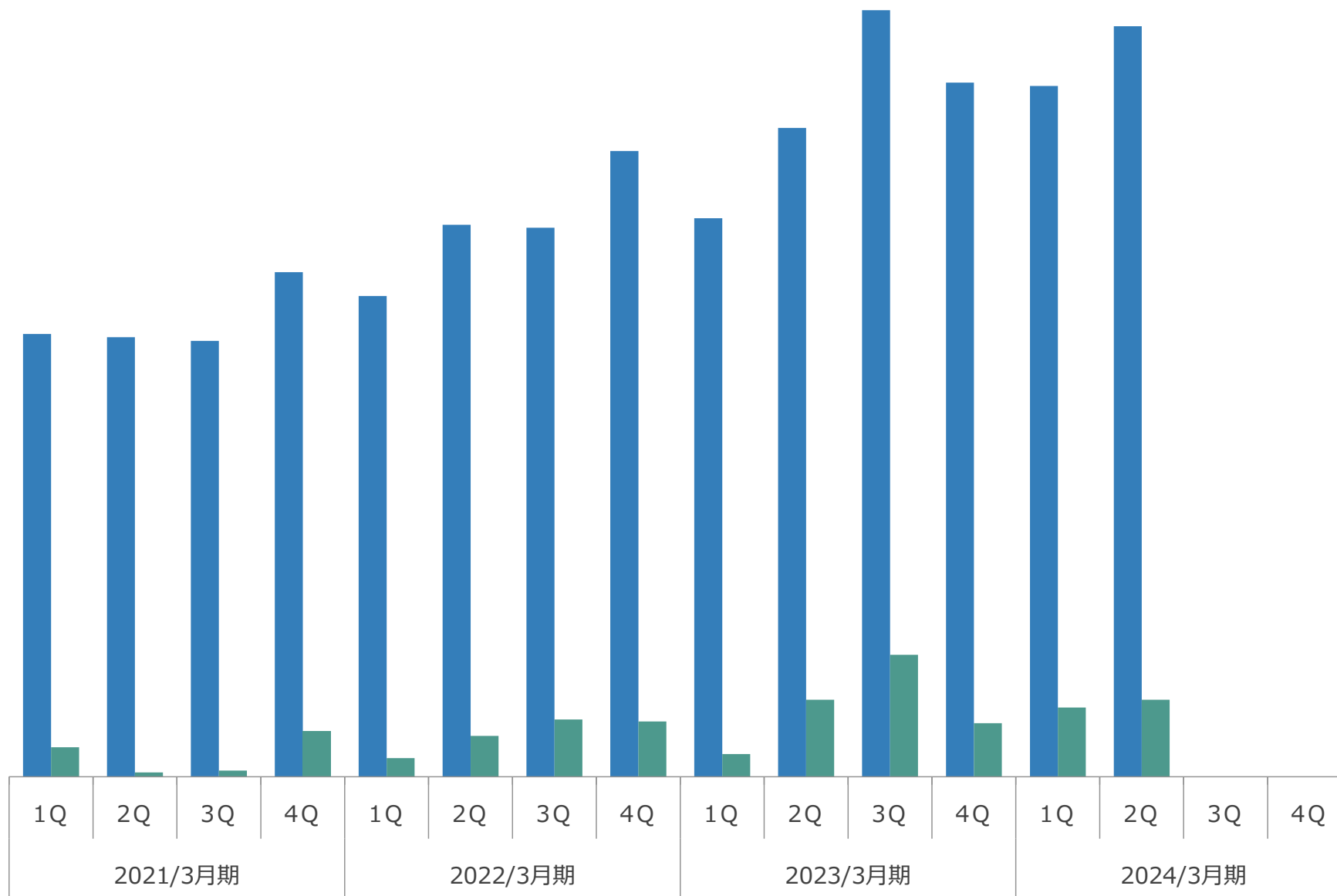
8月29日 個人投資家様向け会社説明会

9月 6日 「第二工場」ISO認証取得

1Q

2Q

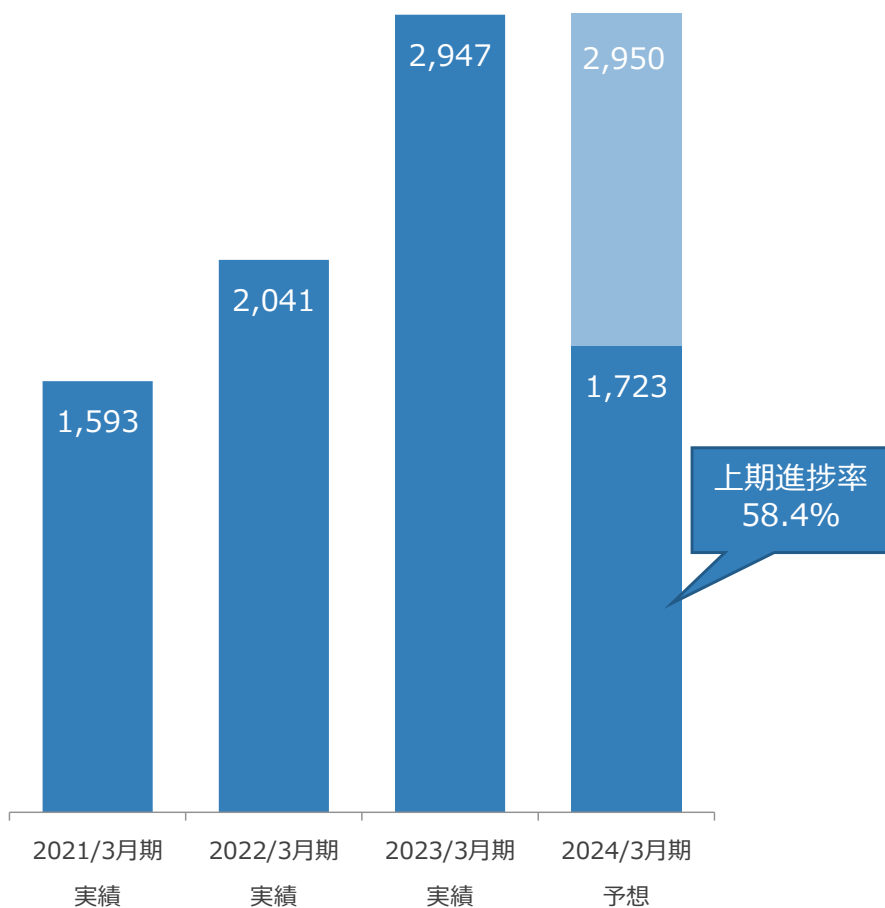
■ 売上高 ■ 経常利益



車載用専用計測機器で顧客立上げ時期が下期以降に一部スライドし前年比減少したが、半導体生産増による後工程商材の受注増、半導体新製品用カスタムバーンイン商材で受注増

【売上高】

(単位：百万円)

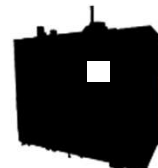


上期トピックス

➤ 車載製品向けを中心に主要商材の受注増



バーンインボード
前年同期比：136%



半導体検査装置販売・リース
前年同期比：285%



車載製品用専用計測機器関連
前年同期比：88%

➤ 魚津第2工場本格稼働開始



7月
セキュリティ
ルーム完成

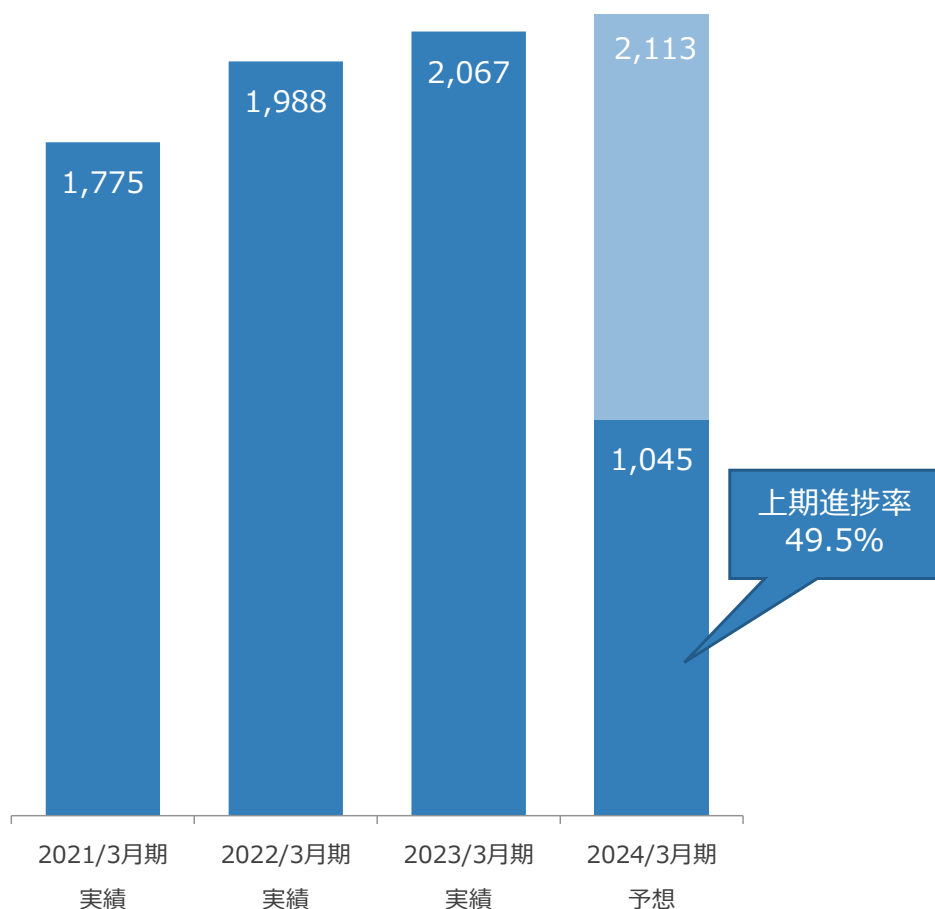


7月
バーンイン装置
のメンテナンス
業務・受託試験
業務開始

アナログはセンサー用半導体の設計を維持、自動車向けパワー半導体の設計も順調に推移。
デジタルはDSC画像処理関連の設計需要が徐々に減少、自動車向け設計受託へのシフトが順調。

【売上高】

(単位：百万円)



上期トピックス

➤ アナログ半導体設計受託

自動車向け等パワー半導体
前年同期比：132%



センサー用半導体
前年同期比：105%



➤ デジタル半導体設計受託

DSC等画像処理関連
前年同期比：60%



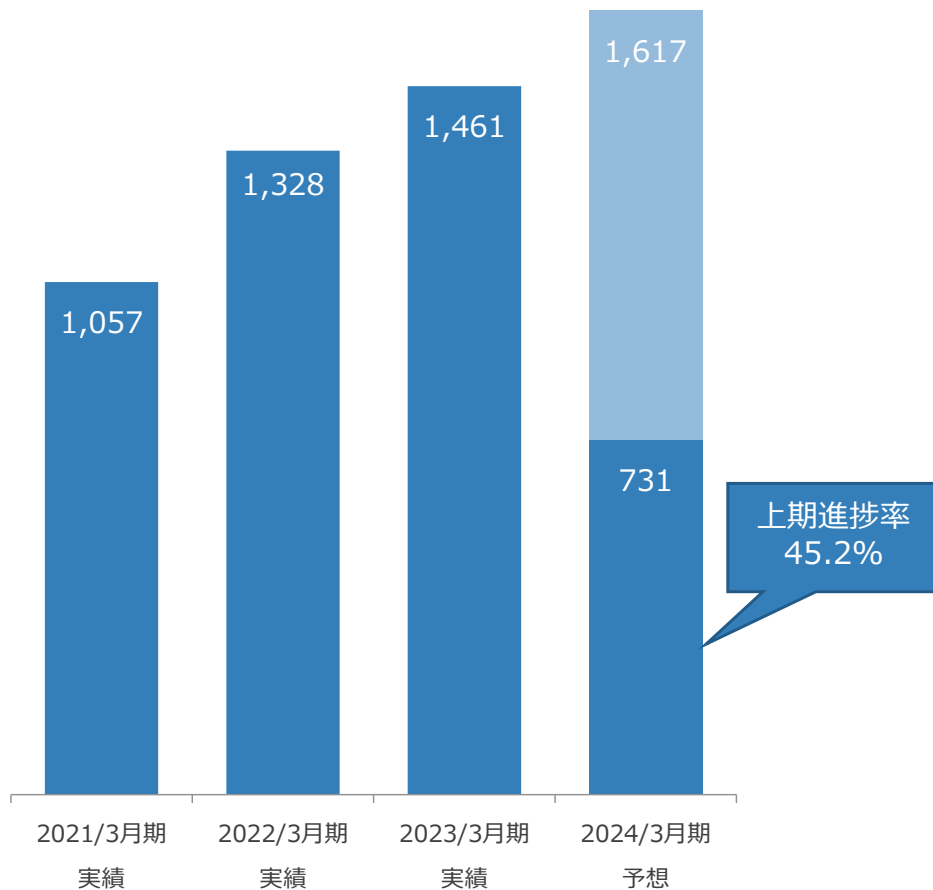
自動車関連デジタル設計
前年同期比：271%



海外ATM向け製品の継続受注、新規国内向けATM量産開始などインフラ向け製品に加え、医療検体機向け製品の復調などにより販売は順調に推移。

【売上高】

(単位：百万円)



上期トピックス

組込カメラモジュール
前年同期比：119%

JAPAN IT WEEK(春) 展示会
IoTソリューション展に出展 (4月)

エッジ
画像処理

3D
ソリューション

シキノハイテック
映像ソリューション

画像
センシング

認識・認証
(顔・文字・物体)

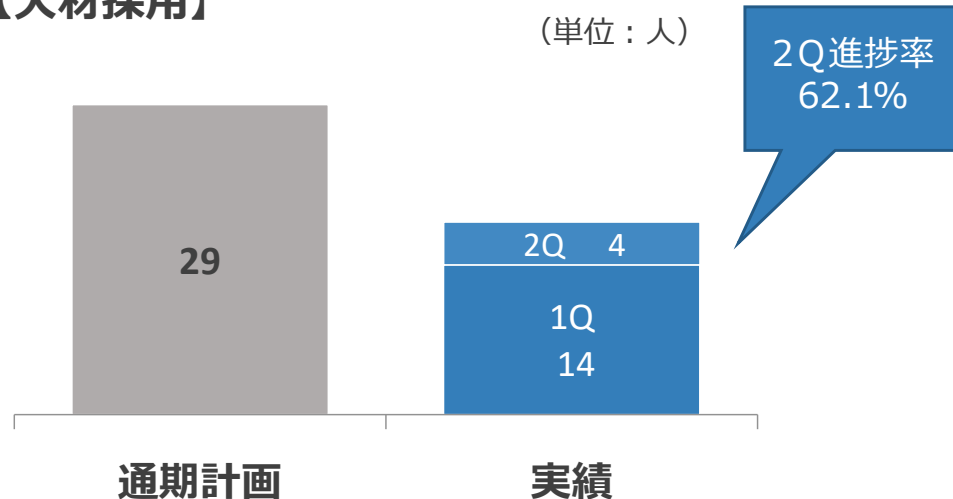
NECプラットフォームズ様より CS向上
納期貢献への感謝状を受領 (7月)

株式会社シキノハイテック様

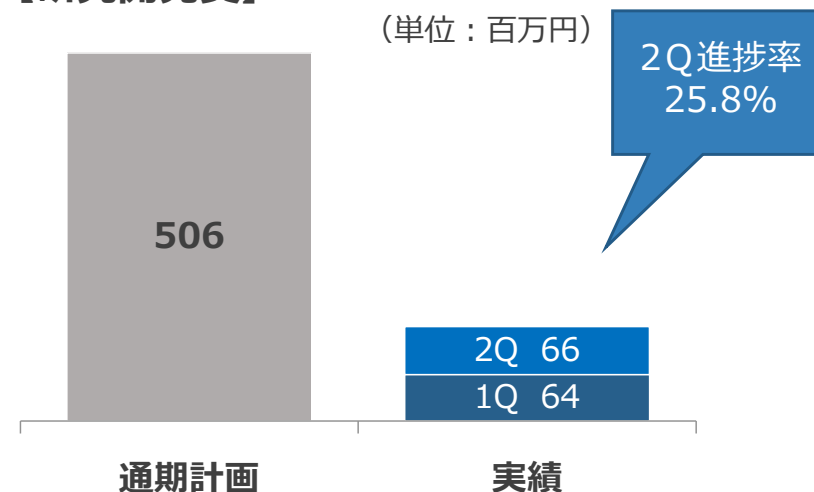
豊富なカスタム対応、技術サポート、長期安定供給、品質保証体制、グリーン対応、小ロット対応

人材採用の進捗率としては順調も、人材争奪戦の更なる激化により2Qの採用実績は苦戦。研究開発は、売上納期対応優先やテーマの見直し・支払時期変更を含めた日程計画見直しにより進捗率未達。

【人材採用】



【研究開発費】



主要開発テーマ

電子システム事業

- ・半導体検査装置・カスタム検査装置
- ・次世代IoT-PLC通信モジュール

マイクロエレクトロニクス事業

- ・次世代JPEG IPコア・画像処理ISP IPコア・アナログIP

製品開発事業

- ・高画素/NWカメラ・3Dカメラ・介護向けシステム

本資料で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

ご注意事項

数字の処理について

当社業績に関する記載金額は特に明記が無い限り、以下の通り処理しております。そのため内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- ・表、グラフの金額：表示単位未満を切り捨て
- ・比率：表示単位第1位未満を四捨五入

お問い合わせ先

株式会社シキノハイテック

常務取締役管理本部長 広田 文男

e-mail : IR-contact@shikino.co.jp

TEL : 0765-22-3477 FAX : 0765-22-3916

ホームページ : <https://www.shikino.co.jp/>